### (19)

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 04288342 A

(43) Date of publication of application: 13.10.92

(51) Int. CI

C08J 5/12 B29C 65/48 C09J165/00

(21) Application number: 03076945

(22) Date of filing: 15.03.91

(71) Applicant:

JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO

LTD

(72) Inventor:

YOSHIDA SOICHI HARA FUJIO

**SEDAKA RYOJI** 

## (54) BONDING METHOD

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To enable the bonding of a thermoplastic tricyclodecane resin excellent in strength and heat resistance by using an adhesive prepared by dissolving the same resin in an organic solvent.

CONSTITUTION: A process for bonding a thermoplastic tricyclodecane resin, e.g. a ring-opening (co)polymer of a monomer of the formula (wherein A and B are each H or 1-10C hydrocarbyl; X and Y are each H, halogen or a monovalent organic group; and n is 0 or 1) and/or its hydroganated derivative, wherein an adhesive prepared by dissolving the same resin in an organic solvent is used. According to the above process, the bonding

strength to the tricycclodecane resin is excellent and so in the heat resistance. Thus it is possible to bond an optical disc, an electircal appliance, a roofing mateiral, an automobile head lamp or an automatic tail lamp cover, each made from this resin, effectively.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

# (19)日本国特許庁(J P)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

# 特開平4-288342

(43)公開日 平成4年(1992)10月13日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
C 0 8 J 5/12		9267-4F		
B 2 9 C 65/48		2126-4F		
C 0 9 J 165/00	JGJ	8215-4 J		

# 審査請求 未請求 請求項の数1(全 6 頁)

(21)出願番号	<b>特顧平3-76945</b>	(71)出願人	000004178 日本合成ゴム株式会社
(22)出顧日	平成3年(1991)3月15日	(72)発明者	東京都中央区築地2丁目11番24号 吉田 宗一 東京都中央区築地2丁目11番24号日本合成
<i>:</i>		(72)発明者	ゴム株式会社内 原 富士雄 東京都中央区築地2丁目11番24号日本合成 ゴム株式会社内
		(72)発明者	瀬高 良司 東京都中央区築地2丁目11番24号日本合成 ゴム株式会社内
•			

# (54)【発明の名称】 接着方法

## (57) 【要約】

【構成】 トリシクロデカン骨格を有する熱可塑性樹脂 を接着する際に、トリシクロデカン骨格を有する熱可塑 性樹脂を有機溶剤に溶解溶剤に溶解した接着剤を用いる ことを特徴とする。

【効果】 トリシクロデカン骨格を有する樹脂を強固に 接着できる。

1

#### 【妹許肄求の範囲】

【請求項1】 トリシクロデカン骨格を有する熱可塑性 樹脂を接着する際に、トリシクロデカン骨格を有する熱 可塑性樹脂を有機溶剤に溶解した接着剤を用いることを 特徴とする接着方法。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、トリシクロデカン骨格 を有する熱可塑性樹脂の接着方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】現在、トリシクロデカン骨格を有する熱 可塑性樹脂は、その光学特性から光ディスク基板に用い られている。光ディスクとしては、コンパクトディスク (CD)、レーザーディスク(LD)、CD-ROM、 CD-Iなど、また光ディスク基板に配録膜などを付着 させ、レーザーによって情報を書き込んで用いるCD-RやDRAW、または情報の読み書きが繰り返しできる E-DRAWディスクなどの光磁気配録用ディスクがあ る。これらの光ディスクのうち光磁気記録用ディスク は、通常、基板を2枚貼り合わせたものをハブで接着し 20 ている。ここで、このハブを接着する際には、一般に知 られている紫外線硬化型接着剤、例えばウレタンアクリ ル系接着剤、エポキシ系接着剤、 (メタ) アクリロイル 系接着剤などが用いられていた。

### [0003]

【発明が解決しようとする問題点】しかし、トリシクロ デカン骨格を有する熱可塑性樹脂を紫外線硬化型接着剤 を用いて接着しても、十分な接着強度が得られないとい う問題点があった。

#### [0004]

【発明を解決するための手段】本発明は、上記問題点を 解決するものとしてトリシクロデカン骨格を有する熱可 塑性樹脂を接着するにあたって、トリシクロデカン骨格 を有する熱可塑性樹脂を有機溶剤に溶解した接着剤を用 いることを特徴とする接着方法を提供するものである。 本発明において、トリシクロデカン骨格を有する熱可塑 性樹脂としては、例えば下配化1で表わされる少なくと も1種の単量体の関環(共)重合体および/または該関 環(共)重合体の水素添加重合体が挙げられる。(以 下、これらを「ノルボルネン系(共)重合体」とい 40 う。)

[0005]

(化1)

(化1中、AおよびBは水素原子または炭素数1~10

原子または一価の有機基を示し、mは0または1であ る。) 上記化1におけるXまたはYが極性基、特に式-(CH<sub>2</sub>) n COOR で表わされるカルポン酸エステ ル基である特定単量体は、得られるノルボルネン系重合 体が高いガラス転移温度と低い吸湿性を有するものとな る点で好ましい。上配の化1において、R\* は炭素原子 数1~12の炭化水素基である。また、nの値が小さい ものほど、得られる重合体のガラス転移温度が高くなる ので好ましく、さらにnがOである特定単量体は、その 合成が容易である点で、また得られる重合体のガラス転 移温度が高いものとなる点で好ましい。さらに、上記化 1におけるAおよびBはアルキル基、特にメチル基であ ることが好ましく、特にこのアルキル基が、上記のカル ポン酸エステル基が結合した炭素原子と同一の炭素原子 に結合されていることが好ましい。また、上配化1にお いてmが1である特定単量体は、ガラス転移点の高い重 合体が得られる点でmが0のものより好ましい。

【0006】上配化1で表わされる特定単量体の具体例 としては、ビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、 テトラシクロ [4, 4, 0, 2,5, 17,10] -3-ドデ セン、ヘキサシクロ [6. 6. 1. 13.5 . 02.7 . 0 1.14] -4-ヘプタデセン、トリシクロイ[5.2. 1. 0\*.6 ] -8-デセン、ペンタシクロ[6.5. 1. 13.6 . 02.7 . 09.18] -4-ベンタデセン、ヘ プタシクロ [8. 7. 0. 13.8 、14.7 111.17 、0 **1.8** . 0<sup>12.16</sup> ] −5−イコセン、トリシクロ [4. 4. 0. 12.5 ] - 3 - デセン、5 - メトキシカルボニ ルピシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーエン、5ーメチ ルー5-メトキシカルポニルビシクロ[2.2.1]へ プトー2ーエン、5ーシアノビシクロ[2.2.1]へ プトー2-エン、8-メトキシカルボニルテトラシクロ [4. 4. 0. 12.5. 17.10] - 3-ドデセン、8-メチルー8-メトキシカルポニルテトラシクロ[4. 4. 0. 1 \*\* . 1 \*\* . 1 \*\* . 9 - メチル -8-メトキシカルポニルテトラシクロ[4.4.0. 12.6 . 17.10] - 3 - ドデセン、その他を挙げること ができる。上記の特定単量体は必ずしも単独で用いられ る必要はなく、2種以上を用いて開環共重合することも できる。

【0007】〈共重合性単量体〉開環重合体は、上記の 特定単量体を単独で開環重合させたものであってもよい が、当該特定単量体を共重合性単量体とを開環共重合さ せたものであってもよい。この場合に使用される共重合 性単量体の具体例としては、シクロプテン、シクロペン テン、シクロヘプテン、シクロオクテン、トリシクロ [5. 2. 1. 02.8] - 3 - デセンなどのシクロオレ フィンを挙げることができる。さらに、ポリプタジエ ン、ポリイソプレン、スチレン-プタジエン共重合体、 エチレンープロピレンー非共役ジエン共重合体、ポリノ の炭化水素基であり、XおよびYは水素原子、ハロゲン 50 ルポルネンなどの主鎖に炭素一炭素間二重結合を含む不

飽和炭化水紫系ポリマーなどの存在下に特定単量体を開 環重合させてもよい。そして、この場合に得られる開環 共重合体の水素添加物は、耐衝撃性の大きい樹脂の原料 として有用である。

【0008】 <開環重合触媒>開環重合反応は、ルテニ ウム、ロジウム、パラジウム、イリジウム、白金などの 白金族化合物の存在下に行なわれる。また、(a)W、 MoおよびReの化合物から選ばれた少なくとも1種 と、(b)デミングの周期律表IA族元素(例えばし I、Na、Kなど)、IIA族元素(例えばMg、Ca 10 など)、IIB族元素(例えばZn、Cd、Hgな ど)、IIIA族元素(例えばB、A1など)、IVA 族元素(例えばSi、Sn、Pなど)、あるいはIVB 族元素 (例えばTi、Zェなど) の化合物であって、少 なくとも1つの当該元素-炭素結合あるいは当該元素-水素結合を有するものから選ばれた少なくとも1種との 組合せからなる触媒であってもよく、またこの場合に触 蝶の活性を高めるために、アルコール類、アルデヒド 類、ケトン類、アミン類などが添加されたものであって

【0009】〈開環重合反応溶媒〉上配のメタセシス重 合反応のための溶媒として、次の溶媒Aもしくは溶媒B またはこれらの混合物が好ましく用いられる。溶媒A は、溶媒成分(1)と溶媒成分(2)との混合物よりな るものである。溶媒成分(1)としては、炭素数が10 以下、好ましくは5~8の脂環族飽和炭化水素および/ または脂肪族飽和炭化水素が用いられる。ここに、脂環 族飽和炭化水素の具体例としては、シクロペンタン、メ チルシクロペンタン、シクロヘキサン、メチルシクロヘ キサン、ジメチルシクロヘキサン、エチルシクロヘキサ 30 ン、シクロヘプタン、デカリンなどを挙げることがで き、また脂肪族飽和炭化水素の具体例としては、n-ペ ンタン、イソペンタン、n-ヘキサン、n-ヘプタン、 nーオクタンなどを挙げることができる。溶媒成分 (2) としては、ジアルキルグリコールエーテルが用い られる。その具体例としては、エチレングリコールジメ チルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテル、 エチレングリコールジプチルエーテル、ジエチレングリ コールジメチルエーテル、ジエチルングリコールジエチ ルエーテル、ジエチレングリコールジプチルエーテル、 トリエチレングリコールジメチルエーテルなどを挙げる ことができる。

【0010】溶媒Aにおける溶媒成分(1)と溶媒成分 (2) の混合比 [溶媒成分 (1) : 溶媒成分 (2)] は、通常、重量比で95:5~30:70、好ましくは 90:10~40:60とされる。溶媒成分(1)の割 合が過大である場合には、溶媒Aの生成重合体に対する 溶解度が不十分となり、一方、この割合が過小である場 合には、メタセシス開環重合反応の反応活性が低くなっ

は、例えばペンゼン、トリエン、キシレン、エチルペン ゼンなどの炭素数が6~10の芳香族炭化水素、あるい はペンタン、ヘキサン、ヘプタン、ノナン、デカンなど のアルカン類、シクロヘキサン、シクロヘブタン、シク ロオクタン、デカリン、ノルボルナンなどのシクロアル カン類、クロルプタン、プロムヘキサン、ジクロルエタ ン、ヘキサメチレンジプロミド、クロルペンゼンなどの ハロゲン化アルカン、アリールなどの化合物、酢酸エチ ル、プロピオン酸メチルなどの飽和カルボン酸エステル 類などを挙げることができる。これらの溶媒は1種のみ でなく、2種以上を用いることもできる。上記の溶媒に よって行なわれるメタセシス開環重合反応において、モ ノマー濃度は、通常10~40重量%とされる。

【0011】〈開環重合体の分子量〉本発明において水 素添加反応の対象とされる開環重合体は、分子量の大き さが固有粘度 (nima) で0.2~5.0である範囲の ものが好適である。一般的に分子量が大きくなるに従っ て高い水素添加率を得ることが困難となる傾向がある。 開環重合体の分子量は重合温度、触媒の種類、溶媒の種 類によっても調整することができるが、より好ましく は、1-プテン、1-ペンテン、1-ヘキセン、1-オ クテンなどのαーオレフィン類などを反応系に共存さ せ、その量を変えることによって調整することが好まし

【0012】 <水素添加触媒>開環重合体の水素添加反 応において使用する水素添加触媒としては、①チタン、 コパルト、ニッケルなどの有機酸塩またはアセチルアセ トン塩と、リチウム、マグネシウム、アルミニウム、ス ズなどの有機金属化合物とを組み合わせた、いわゆるチ グラータイプの均一系触媒、②パラジウム、白金、ルテ ニウム、ロジウムなどの貴金属を、カーボン、アルミ ナ、シリカアルミナ、シリカマグネシア、ケイソウ土な どの担体に担持した担持型貴金属系触媒、③ロジウム、 レニウム、ルテニウムなどの貴金属鎖体触媒などを挙げ ることができる。

【0013】<水素添加反応触媒>水素添加反応触媒と しては、水素添加される開環重合体の良溶媒であって、 しかもそれ自体が水素添加されないものであれば、特に 限定されない。具体的には、前記開環重合反応触媒と同 様のものを挙げることができる。水素添加反応に供され る重合体溶液中の開環重合体の濃度は、通常、1~40 重量%とされ、好ましくは3~30重量%、さらに好ま しくは5~20重量%とされる。 開環重合体の濃度が高 すぎると大きい反応速度が得られず、一方、低すぎると 経済的に不利となる。

【0014】<水素添加反応>水素添加反応の温度は、 通常、0~200℃とされ、好ましくは20~150 ℃、さらに好ましくは30~100℃である。この温度 が低い場合には大きい反応速度が得られず、一方、温度 て高い重合度の重合体を得ることができない。榕媒B 60 が高過ぎると触媒が失活するおそれがあるので好ましく

ない。反応系の圧力は、通常、1~200kg/cm²とさ れ、好ましくは2~150kg/cm²、さらに好ましくは 5~120kg/cm² とされる。圧力が低いと大きい反応 速度が得られず、一方、圧力を高くすると大きい反応速 度が得られるが、装置として高価な耐圧装置が必要にな るので経済的でない。反応に有する時間は、開環重合体 の濃度、圧力とも関連するが、通常、30分間~100 時間の範囲、好ましくは1時間~30時間の範囲で選定 される。次に、トリシクロデカン骨格を有する熱可塑性 樹脂を有機溶剤に溶解した接着剤に用いられるトリシク 10 ロデカン骨格を有する熱可塑性樹脂は、接着するトリシ クロデカン骨格を有する熱可塑性樹脂と同一のものを使 用することが好ましい。有機溶剤としては、トリシクロ デカン骨格を有する熱可塑性樹脂の良溶媒であればよ い。例えば、前配ノルボルネン系(共)重合体を接着す るには、接着するノルボルネン系 (共) 重合体と同一の 重合体をノルボルネン系(共)重合体の開環重合時に用 いたものと同様の有機溶媒、例えばジシクロメタン、ト リクロロエチレン、パークロロエチレン、クロロホル ム、三塩化エチレン、一塩化ペンゼンなどのハロゲン化 20 炭化水素やテトラヒドロフラン、好ましくはジクロロメ タン、クロロホルム、テトラヒドロフランなどに溶解し たものを用いる。ここでノルボルネン系(共)重合体 は、有機溶媒100重量部に対して、通常、10~25 0重量部、好ましくは20~100重量部溶解する。

【0015】本発明の接着方法は、例えば光磁気記録用 ディスクにおけるハブの接着に好適に用いることができ る。例えば、光磁気配録用ディスクの透明基板としてノ ルポルネン系(共)重合体の水添物を用い、ハブとして も透明基板と同一のノルボルネン(系)重合体の水添物 からなるものを用い、この透明基板とハブを接着する場 合に、ノルボルネン系(共)重合体を有機溶剤に溶解し た接着剤を用いる。ここでハブを透明基板に接着するに は、例えば図1および図2に示されるような方法が挙げ られる。図1および図2はハブと透明基板を接着したも のの断面図である。図1における1および図2における 5はハブ、図1における3,3′および図2における 7, 7′は透明基板、図1における2および図2におけ る6は接着剤を示す。なお、接着剤は通常、ディスペン サーにより一定量をディスクに流される。本発明の接着 方法によれば、トリシクロデカン骨格を有する熱可塑性 樹脂同士はもちろん、トリシクロデカン骨格を有する熱 可塑性樹脂と他の熱可塑性樹脂、例えばスチレン系樹 脂、ゴム強化スチレン系樹脂、塩化ビニル系樹脂、アク リル系樹脂、ポリフェニレンエーテル樹脂、ポリアリレ ーンスルフィド樹脂、ポリカーポネート樹脂、ポリエス テル樹脂、ポリアミド樹脂、ポリアセタール樹脂、ポリ エーテルスルホン樹脂、ポリスルホン樹脂、ポリイミド 樹脂、ポリオレフィン系樹脂などや、ゴム、金属などと 接着することができる。

[0016]

【実施例】以下に実施例を挙げて本発明をさらに具体的 に説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるもの ではない。なお、実施例中、部および%は、特に断わら ない限り重量基準である。また、実施例中の各種の例定 は次の通りである。

6

### 接着(引張)強度

島津製作所(株)製、オートグラフDSS-2000を 使用し、引張速度5mm/secの条件にて接着強度を測定 した。

【0017】 [実施例1] 射出成形機に角柱用金型を取付けて、シリンダー温度300℃、金型温度120℃で射出成形し、1/2×1/4×5インチのポリカーポネート樹脂と水素化ノルポルネン系樹脂の角柱を得た。この2本の角柱をジクロロメタン100部に対して水素化ノルポルネン系樹脂(n:0.45)20部を入れ、完全に溶解させた接着剤を用いて接着し、引張強度試験を行なった結果、41kg/cm²の接着強度が得られた。なお、ポリカーポネート樹脂としては帝人化成社製(AD5503)を用い、水素化ノルポルネン樹脂としては以下のものを用いた。

【0018】 <水素化ノルボルネン樹脂>8-メチルー 8-メトキシカルポニルテトラシクロ[4.4.0.1 \*.5 、1<sup>7.10</sup>] ドデカー3ーエン100g、1,2ージ メトキシエタン60g、シクロヘキサン240g、1-ヘキセン25g、およびジエチルアルミニウムクロライ ド0.96モル/リットルのトルエン溶液3.4ミリリ ットルを、内容積1リットルのオートクレープに加え た。一方、別のフラスコに、六塩化タングステンの0. 05モル/リットルの1,2-ジメトキシエタン溶液2 0ミリリットルとパラアルデヒドの0.1モル/リット ルの1,2-ジメトキシエタン溶液10ミリリットルを 混合した。この混合溶液4. 9ミリリットルを、前記才 ートクレーブ中の混合物に添加した。密栓後、混合物を 80℃に加熱して3時間撹拌を行なった。得られた重合 体溶液に、1、2-ジメトキシエタンとシクロヘキサン の2/8 (重量比) の混合溶媒を加えて、重合体/溶媒 が1/10 (重量比) にした後、トリエタノールアミン 20gを加えて10分撹拌した。

0 【0019】この重合溶液に、メタノール500gを加 えて30分間撹拌して静置した。2層に分離した上層を 除き、再びメタノールを加えて撹拌、静置後、上層を除 いた。同様の操作をさらに2回行ない、得られた下層を シクロヘキサン、1、2-ジメトキシエタンで適宜希釈 し、重合体濃度が10%のシクロヘキサン-1、2-ジ メトキシエタン溶液を得た。この溶液に、20gのバラ ジウム/シリカマグネシア(日揮化学(株)製、バラジ ウム量=5%)を加えて、オートクレーブ中で水素圧4 0kg/cm² として165℃で4時間反応させた後、水添 の 触媒をろ過によって取り除き、水添重合体溶液を得た。

また、この水極重合体溶液に、酸化防止剤であるベンタエリスリチルーテトラキス [3-(3,5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート]を水極重合体に対して0.1%加えてから、380℃で減圧化に脱溶媒を行なって、水素化ノルボルネン樹脂を得た。

【0021】 [実施例3] 実施例1において、接着剤としてジシクロメタン100部に対し、水素化ノルボルネン系樹脂20部を混合溶解させた接着剤を用いた以外は、実施例1と同様にしてボリカーボネート樹脂の角柱と水素化ノルボルネン系樹脂の角柱とを接着し、引張強度試験を行なった結果、46kg/cm² の接着強度が得られた

【0022】[実施例4] 実施例1において、接着剤としてテトラヒドロフラン100部に対し、水素化ノルボルネン系樹脂40部を混合溶解させた接着剤を用いた以外は、実施例1と同様にして水素化ノルボルネン系樹脂の角柱2本を接着し、引張試験を行なった結果、105kg/cm²の接着強度が得られた。

【0023】 [実施例5] 光ディスク専用の射出成形機で光磁気配録媒体用金型にピット、セクター、トラックなどを転写するためのスパンターを取付けたものを用いて、シリンダー温度350℃、金型温度130℃で、130mφ、1.2m厚みの水素化ノルボルネン系の樹脂にて基板を成形して得た。この基板に、実施例1と同様

の水素化ノルボルネン系樹脂を用いたハブをテトラヒドロフラン100部に対して、水素化ノルボルネン系樹脂30部を混合溶解した接着剤を用いて接着し、引張試験による接着強度を求めた結果、49kgの結果が得られた。

8

【0024】 [実施例6] 実施例5と同一条件で作られた水素化ノルボルネン系樹脂基板のハブ接着した試験片を、75℃×85%の雰囲気化の条件に50hr、100hr保持した後の接着強度を測定した結果、50hrで42kg、100hrで45kgであった。

【0025】 [比較例1] 実施例5で得られた光ディスク基板とハブを用いて、紫外線硬化樹脂による接着を実施し、引張試験による測定を行なった結果、25kgであった。

【0026】 [比較例2] 比較例2のものを75℃×8 5%雰囲気下に50hr、100hr保持した後の接着強度 を測定した結果、50hrで20kg、100hrで15kgで あった。

[0027]

20 【発明の効果】本発明の接着方法によれば、トリシクロデカン骨格を有する熱可塑性樹脂の接着性に優れ、耐熱性にも優れている。このため、トリシクロデカン骨格を有する熱可塑性樹脂からなる光ディスク、電気製品および屋根材と自動者用ヘッドランプとテールカバーなどを効率よく接着できる。

[0028]

【図面の説明】第1図および第2図は、ハブと透明基板とをつけたものの断面図である。

- 1、1′、5----ハ ブ
- - 3、3′、7、7′--透明基板

【図1】





